下载日志已记录，仅供内部参考

通信

证券研究报告
2026 年 07 月 22 日

硅光晶圆代工量产与扩产密集落地，光模块/NPO/CPO 等拉高需求

硅光晶圆代工量产与扩产密集落地

硅光全称硅基光电子，拥有四项不可替代的核心优势，也是各大厂商发力 AI 高速光模块的关键原因。2026 年以来，全球主要晶圆代工厂在硅光子领域的动作明显提速。联电宣布新加坡厂完成首批硅光子晶圆量产交货，成为近期最受关注的量产里程碑。而在此之前，台积电的 COUPE 硅光整合平台已于 2026 年进入量产阶段，PIC 月产能正快速爬坡。高塔半导体随即公布大规模扩产计划，格芯则通过并购完成产能整合。与此同时，中国大陆的粤芯半导体也在 2025 年建成了首条 12 英寸硅光芯片量产线。

市场研究机构 LightCounting 在最新报告中指出，2026 年基于硅光的光模块销售额将首次超过整体市场的 50%。NPO/CPO 的部署正加速硅光的应用，并带动 InP CW 激光器需求的增长。博通、英伟达和台积电等巨头再次推动了这一转变。

本周投资观点：

我们认为，在整体宏观环境变化复杂背景下，把握核心高景气行业与资产是重要选择。我们仍坚定看好算力产业链核心标的的投资机会，AI 带动算力供应链核心标的有望实现较好的业务增长，重视产业链核心厂商。其中，海外算力产业链高景气度依旧，相关公司财报持续体现 AI 相关需求的高景气，相关产业链的基本面共振更强，我们持续看好海外算力产业链投资机会。国内方面，后续伴随着国产算力持续发展，大厂如阿里、字节等对于 AI 的持续投资，仍然看好 AI 行业以及围绕 AIDC 产业链的持续高景气。整体上我们积极看好 26 年国内 AI 基础设施需求延续高景气，同时应用有望持续开花结果。中美 AI 均进展不断，同时推理端持续推进。建议持续关注 AI 产业动态及 AI 应用的投资机会。

中长期我们建议持续重视“AI+出海+卫星”核心标的的投资机会：海外线 AI 核心方向如光模块&光器件、液冷等领域值得重视，持续核心推荐；此外国产算力线如国产服务器，交换机，AIDC、液冷等方向核心标的建议积极关注。海风行业国内加速复苏，海外出海具备良好机遇，积极把握产业变化，核心推荐海缆龙头厂商。近期看到商业航天产业国内动态进展呈现，看好后续产业受催化拉动。

一、人工智能与数字经济：

1、**光模块**&光器件，**推荐：中际旭创、新易盛、天孚通信**、源杰科技（电子联合覆盖）；相关标的：东山精密、剑桥科技、长芯博创、仕佳光子、鼎通科技、光库科技、华懋科技（电新汽车团队联合覆盖）、致尚科技、罗博特科、中瓷电子、太辰光、德科立等。

2、**光纤光缆，推荐：亨通光电、中天科技、长飞光纤、永鼎股份**；相关标的：杭电股份、特发信息、通鼎互联等。

3、**交换机服务器 PCB**：推荐：**沪电股份（电子组联合覆盖）**、菲菱科思；**相关标的**：盛科通信、锐捷网络、胜宏科技、三旺通信、映翰通等。

4、**低估值、高分红，云和算力 idc 资源重估：中国移动、中国电信、中国联通。**

5、**AIDC&散热：**推荐：**英维克（机械联合覆盖）、润泽科技**（机械联合覆盖）、润建股份、**光环新网、科华数据**（电新联合覆盖）、奥飞数据（计算机联合覆盖）、**数据港**（计算机联合覆盖）。相关标的：大位科技、**申菱环境**（家电覆盖）、宏景科技、高澜股份、科创新源等。

6、**AIGC 应用/端侧算力**，推荐：**移远通信、广和通、美格智能**，相关标的：**彩讯股份、梦网科技、翱捷科技（电子组覆盖）。**

二、物联网&智能驾驶：

1、**出海复苏&头部集中，推荐：威胜信息（机械联合覆盖）、拓邦股份**（电子联合覆盖）、**亿联网络、广和通、美格智能**等，相关标的：**华测导航、和而泰（电子家电团队联合覆盖）**、移远通信、移为通信。

2、智能驾驶：相关标的：模组&终端（广和通、美格智能、移远通信、移为通信等）；传感器（汉威科技&四方光电-机械联合覆盖）；连接器（意华股份、鼎通科技等）；结构件&空气悬挂（瑞玛精密）等。

三、商业航天：

低轨卫星加速发展，低空经济积极推进，相关标的：**铖昌科技、华测导航**、盛路通信、信科移动、佳缘科技、盟升电子、中国卫通、电科网安、**震有科技、通宇通讯**等。

其他细分领域标的：**中兴通讯、紫光股份（计算机联合覆盖）、亨通光电、中天科技、光迅科技、烽火通信、海格通信、上海瀚讯**、海能达、电科网安。

风险提示：AI 进展低于预期，下游应用推广不及预期，贸易摩擦等风险，报告中“相关标的”仅为对相关公司的罗列，不构成任何投资建议。

投资评级

行业评级	强于大市(维持评级)
上次评级	强于大市

作者

王奕红 分析师
SAC 执业证书编号：S1110517090004
wangyihong@tfzq.com

唐海清 分析师
SAC 执业证书编号：S1110517030002
tanghaiqing@tfzq.com

康志毅 分析师
SAC 执业证书编号：S1110522120002
kangzhiyi@tfzq.com

余芳沁 分析师
SAC 执业证书编号：S1110521080006
yufangqin@tfzq.com

袁昊 分析师
SAC 执业证书编号：S1110524050002
yuanhao@tfzq.com

陈汇丰 分析师
SAC 执业证书编号：S1110522070001
chenhuifeng@tfzq.com

张建宇 分析师
SAC 执业证书编号：S1110525040002
zhangjianyu@tfzq.com

曾庆亮 分析师
SAC 执业证书编号：S1110526020004
zengqingliang@tfzq.com

行业走势图



资料来源：聚源数据

相关报告

1 《通信-行业研究周报:烽火通信加码扩产，商业航天“网系回收”开启低成本组网新周期》2026-07-15

2 《通信-行业研究周报:AI 技术快速发展，算力租赁行业景气度旺盛》2026-07-06

3 《通信-行业研究周报:AI 算力催生高密度互连需求，康宁“玻璃桥”重塑 CPO 先进封装新格局》2026-06-29

下载日志已记录，仅供内部参考

重点标的推荐

股票代码	股票名称	收盘价（元）2026-07-21	投资评级	EPS(元) 2025A	2026E	2027E	2028E	P/E 2025A	2026E	2027E	2028E
300308.SZ	中际旭创	1136.55	买入	9.72	24.47	52.75	74.91	116.96	46.45	21.55	15.17
300394.SZ	天孚通信	231.00	增持	2.59	3.92	5.15	7.08	89.02	58.93	44.85	32.63
300502.SZ	新易盛	551.77	买入	9.59	18.58	25.03	31.32	57.54	29.70	22.04	17.62
002463.SZ	沪电股份	122.60	增持	1.99	2.70	3.52		61.72	45.41	34.83	
600522.SH	中天科技	34.63	买入	0.85	1.20	1.47		40.72	28.86	23.56	
600487.SH	亨通光电	59.96	买入	1.09	3.49	4.34	5.03	55.18	17.18	13.82	11.92
688498.SH	源杰科技	1510.00	增持	2.22	4.16	6.67		679.75	362.98	226.39	
000063.SZ	中兴通讯	34.88	增持	1.17	1.19	1.36	1.54	29.70	29.31	25.65	22.65
600941.SH	中国移动	94.94	买入	6.33	5.90	6.20	6.51	14.99	16.09	15.31	14.58
300442.SZ	润泽科技	68.71	买入	3.09	1.87	2.57	3.48	22.24	36.74	26.74	19.74
300638.SZ	广和通	19.90	增持	0.39	0.90	1.12		51.57	22.11	17.77	
002139.SZ	拓邦股份	9.99	买入	0.29	0.41	0.56	0.65	34.24	24.37	17.84	15.37
688100.SH	威胜信息	29.51	买入	1.36	1.75	2.13	2.56	21.78	16.86	13.85	11.53
300628.SZ	亿联网络	37.75	买入	2.05	2.46	2.83		18.39	15.35	13.34	
002837.SZ	英维克	59.99	增持	0.53	1.05	1.46		112.30	57.13	41.09	

资料来源：Wind，天风证券研究所

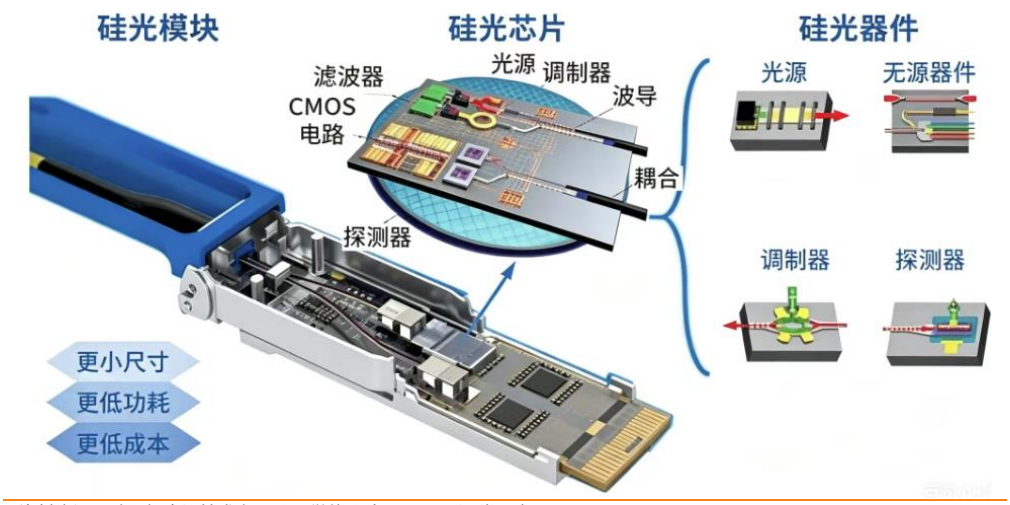
下载日志已记录，仅供内部参考

1. 硅光晶圆代工量产与扩产密集落地，光模块/NPO/CPO 等拉高需求

硅光全称硅基光电子，英文名称 SiliconPhotonics，行业内统一简称为 SiPh，大家日常交流也会叫硅光子。它最核心的定义可以简单概括为：硅光=成熟 CMOS 半导体工艺+光子传输技术。传统光器件和芯片制造是两条完全分开的产业链，而硅光巧妙把二者结合，依托市面上已经成熟完善的 CMOS 晶圆制造体系，把原本零散组装的光通信零部件，全部集成制作在硅芯片上，让光器件能像手机处理器、电脑 CPU 一样标准化、大规模量产。

硅光方案拥有四项不可替代的核心优势，也是各大厂商发力 AI 高速光模块的关键原因。第一，能够直接使用主流 CMOS 晶圆厂成熟半导体工艺，现有芯片产线仅需小幅工艺调整就能投产，不用投入巨额资金新建专属产线，产业链配套成熟落地更快。第二，可实现超高 PIC 光子集成电路密度，相比传统分立器件方案，硅光芯片能把大量光学功能结构压缩在极小面积内，大幅缩小光模块整体体积，适配 AI 服务器高密度布线的机柜场景。第三，完全适配百万级大规模量产，晶圆制造天生适合批量生产，一张大尺寸硅片可切割出数百上千颗光芯片，能够承接 AI 算力集群海量光模块订单。第四，规模化量产之后更容易持续摊薄单片成本，随着 800G、1.6T 光模块需求持续走高，硅光是长期推动高速光模块降价普及的核心路线。

图 1：硅光模块和硅光芯片示意图



资料来源：武汉恒泰通技术有限公司微信公众号，天风证券研究所

高价值模拟半导体解决方案领先代工厂 Tower Semiconductor 于 2026 年 7 月 14 日宣布，在日本政府支持下，启动一项双轨并行的战略扩产计划，重点扩大其 300mm 硅光子、硅锗及先进封装产能。本次扩产旨在支持日益增长的客户需求，大幅提升公司制造产能，巩固自身技术领先地位。

本次双线扩产项目预计 Tower 总投入约 30 亿美元，日本政府将提供 10 亿美元补助。该笔投资将为 Tower 与日本双方创造长期价值，在本土搭建完善的硅光、锗硅高端制造能力，完善日本半导体产业生态，提升产业链供应链抗风险能力。

而 2026 年以来，全球主要晶圆代工厂在硅光子领域的动作明显提速。联电宣布新加坡厂完成首批硅光子晶圆量产交货，成为近期最受关注的量产里程碑。而在此之前，台积电的 COUPE 硅光整合平台已于 2026 年进入量产阶段，PIC 月产能正快速爬坡。高塔半导体随即公布大规模扩产计划，格芯则通过并购完成产能整合。与此同时，中国大陆的粤芯半导体也在 2025 年建成了首条 12 英寸硅光芯片量产线。

下载日志已记录，仅供内部参考

图 2：全球主要晶圆代工厂硅光子布局动态

厂商	最新进展	时间节点	技术亮点
联电	首批1.6T硅光子品圆量产交货	2026年7月	18个月从开发到量产；2027年推自有12寸平台
台积电	COUPE平台进入量产，PIC产能快速爬坡	2026年	COUPE+CoWoS+SoIC光电融合；联合SEMI成立硅光子产业联盟
高塔半导体	获日本政府补助，启动扩产计划	量产锚定2027年Q4	日本两地12寸硅光子及硅锗扩产
格芯	收购AMF，整合硅光子产能	2025年11月	纯硅光子代工厂；Fotonix平台+2.5D封装
粤芯半导体	建成12英寸硅光量产线	2025年	90nm→65nm→45nm演进

资料来源：全球半导体观察微信公众号，天风证券研究所

从各家企业公布的时间表来看，2027 年将是一个重要节点。联电计划在 2027 年推出自有 12 英寸硅光子平台，高塔半导体目标于 2027 年第四季度实现量产。多家头部代工厂的产能释放节点高度重合，意味着 2027 年前后可能是硅光子代工产能集中放量的窗口期。

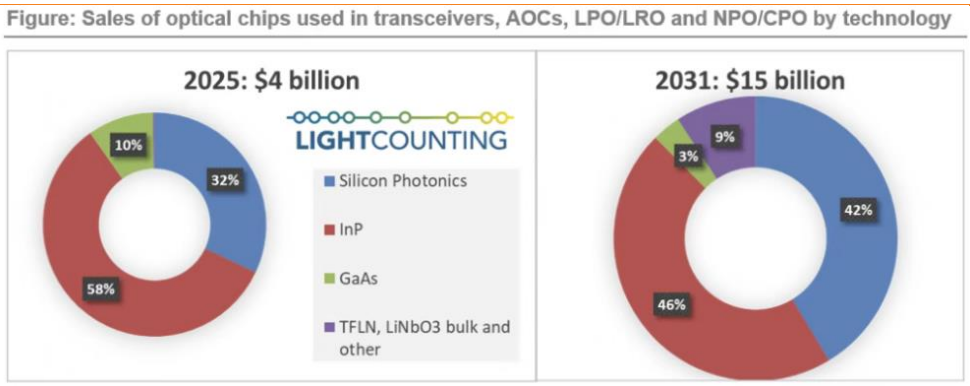
台积电是这一轮硅光子竞赛中布局最为系统的厂商。其硅光整合平台 COUPE（紧凑型通用光子引擎）于 2026 年进入正式量产，通过 SoIC 技术将电子集成电路与光子集成电路进行 3D 堆叠，以提高带宽和功率效率、减少电耦合损耗。据台积电方面披露，全球首款采用 COUPE 技术的 200Gbps 微环调制器已于 2026 年开始生产，并已实现低于一亿分之一的误比特率。

客户层面，英伟达、博通的订单已经落地——博通基于 COUPE 平台的 102.4Tbps CPO 以太网交换机已向早期客户送样，英伟达的 Quantum-X 光子交换机已开始出货。由于初期 PIC 产能有限，2026 至 2027 年主要量产客户预计以英伟达、博通及 AMD 为主。台积电的布局并非单点突破，而是系统性的生态构建——将 COUPE 与 CoWoS、SoIC 等先进封装技术整合，形成光电融合平台。此外，台积电还联合 SEMI 发起成立了硅光子产业联盟，将英伟达、博通、Marvell 等全球巨头拉进同一生态圈。

市场研究机构 LightCounting 在最新报告中指出，2026 年基于硅光的光模块销售额将首次超过整体市场的 50%。尽管硅光技术具备诸多优势，但它花了将近十年的时间才在光模块市场产生重大影响。NPO/CPO 的部署正加速硅光的应用，并带动 InP CW 激光器需求的增长。博通、英伟达和台积电等巨头再次推动了这一转变。

LightCounting 对用于光模块、AOC、LPO、LRO、NPO 和 CPO 的光芯片市场价值的预估。2025 年该市场规模仅为 40 亿美元，但到 2031 年将增长近 4 倍，达到 150 亿美元。到 2031 年，光模块、AOC、NPO 和 CPO 的销售额将达到近 800 亿美元。

图 3：按技术分类的用于光模块、AOCs、LPO/LRO 和 NPO/CPO 的光学芯片销售额



资料来源：C114 通信网微信公众号，天风证券研究所

LightCounting 指出，硅光芯片在 2025 年占据了所有光芯片市场的三分之一，到 2031 年，

下载日志已记录，仅供内部参考

它将贡献总光芯片市场的 42%。这种增长在 2031 年之后仍将持续，因为光互连将从如今的 Scale-out，发展到 Scale-up，未来还将向 Scale-in 演进，即封装内部用于 chiplets 间互连的网络。

此外，这份预测也存在上行的空间。目前的市场增长预期主要来自于 NPO/CPO 在 Scale-up 网络中的应用，而这一预测是基于一个假设：即到 2030 年-2031 年，仅有 10%-15%的 Scale-up 互连将迁移到 NPO/CPO。LightCounting 还预计，Scale-up 网络在机柜内部将继续依赖铜互连，而光互连仅用于多机柜之间的连接。如果未来多机柜 Scale-up 系统得到广泛采用，Scale-up 扩展域的范围远远超 1000 个 GPU，Scale-up 网络开始在机柜内部使用光互连而非铜互连，LightCounting 的预测将会有显著的上行空间。

2. 近期重点行业动态以及观点（7.12-7.18）

2.1. AI 行业动态

月之暗面正式发布 Kimi K3（微信公众号：AI 蓝媒汇）

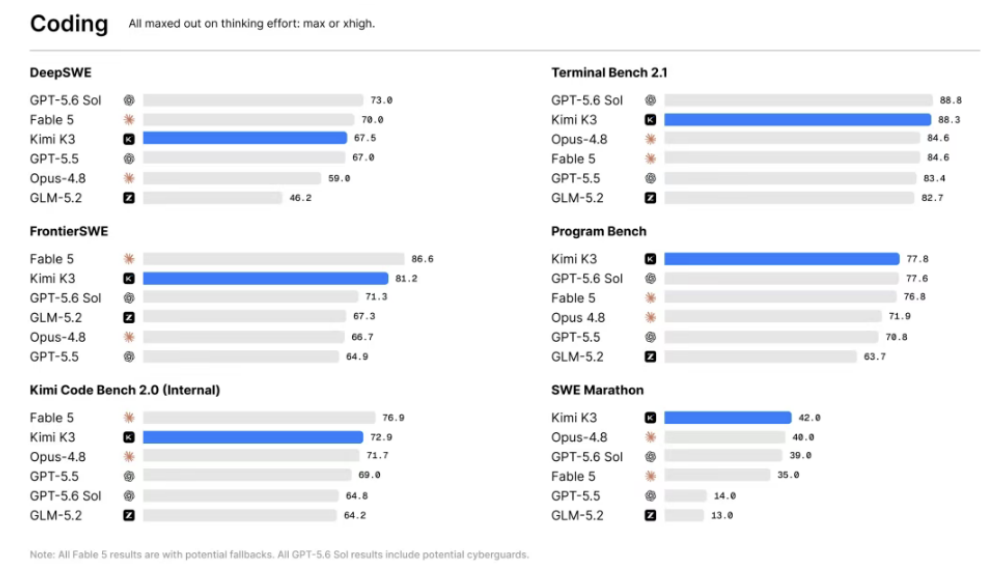
日前，月之暗面正式发布 Kimi K3，2.8 万亿参数，全球最大开源模型，是 Kimi“迄今能力最强的模型”。从综合评测结果来看，K3 整体表现仍落后于闭源模型 Claude Fable 5、GPT-5.6 Sol，但在整套评测中稳定超过了 GPT-5.5、Opus-4.8 等其他模型，并登顶全球 AI 评测平台 Arena AI 的前端编程榜单。如此表现，K3 一经公布，很快在全球 AI 领域引发广泛热议，部分开发者测试之后直言 K3 超预期，有些甚至表示 K3 的发布，或意味着中国开源大模型整体水平已经超越美国同类产品。

首先要明确的是，K3 并不是一次常规迭代，而是一次直击前沿的硬核升级。参数上，K3 的 2.8 万亿是 DeepSeek V4（1.6 万亿）的近两倍，是 K2（约 1 万亿）的近三倍，这极大的拉高了智能上限。“参数越大，能力上限越高，可以提供更智能的模型表现。”月之暗面相关负责人表示，参数就像人脑里的神经连接，近 3 万亿参数意味着这个模型能把更多的知识和规律装进“脑子”，懂得更多、想得更深、答得更准。更在架构上，KDA（Kimi Delta Attention）和 AttnRes（Attention Residuals）的组合，让它不再是简单的 MoE 堆叠，而是从头设计的一套新范式，整体扩展效率较 K2 提升了约 2.5 倍。

Kimi K3 已经在编程、Agent、知识工作和视觉理解等多个方向接近当前第一梯队，并在部分评分项目中取得领先。比如在编码类测试中，K3 的 SWE Marathon 得分 42.0，高于 Claude Fable 5（35.0）和 GPT 5.6 Sol（39.0），拿下第一。在 Agent 能力方面，K3 的 BrowseComp 得分为 91.2，超过 Claude Fable 5 的 88.0 和 GPT 5.6 Sol 的 90.4。视觉方面，在 OmniDocBench 拿到 91.1 分，同样是第一。在多个硬核基准上，K3 实质上已经追平 Claude 和 GPT 的同代旗舰了，即便整体上还存在差距，但明显已经被拉近了。

图 4：编码类测试结果

下载日志已记录，仅供内部参考



资料来源：AI 蓝媒汇微信公众号，天风证券研究所

K3 的定价：缓存命中¥2.00/百万 Token，输入¥20.00/百万 Token，输出¥100.00/百万 Token。输入价格涨了 5 倍，输出价格涨了近 5 倍，这个定价在当下的中国大模型市场简直是"逆行者"。目前国内主流旗舰模型仍普遍坚守低价赛道：DeepSeek V4-Pro、通义千问 Max 等头部模型，输出价格普遍不足 1 元/千 Token，百万 Token 输出成本仅几十元，一众厂商持续靠极致低价收割市场，价格战愈演愈烈，而 K3 的定价直接进入一个完全不同的区间，一个主动对标美国头部模型的价格区间。

中际旭创通过联交所聆讯，赴港上市在即（微信公众号：C114 通信网）

7 月 17 日，中际旭创通过联交所聆讯即将登陆港股。过去十年，中际旭创一直推动技术进步和光模块创新。例如，中际旭创是光互连领域集成硅光技术的先行者，据灼识咨询，中际旭创开发并推出全球首款采用硅光技术的 400G、800G、1.6T 光模块，截至 2026 年 3 月 31 日止三个月，按收入计，采用硅光技术的产品占高速产品系列的约 70%。按收入计，2025 年，中际旭创是全球最大的硅光光模块供应商。据灼识咨询，自 2021 年起，中际旭创是连续五年全球收入规模最大的光互连解决方案提供商，2025 年占整体光互连解决方案市场的 21.2%，其中在高速数通光互连解决方案市场占据 28.1%的市场份额。

本次 H 股上市后，中际旭创将持续加强研发能力，保持在光互连领域的市场地位；持续拓展全球布局；依托数据中心生态系统优势，把握更多商业机遇；持续吸引并凝聚顶尖人才，激发组织活力；有选择性地开展战略收购及行业相关投资。

到 2027 年，中际旭创预计将重点提升 1.6T 光模块在功耗、信号损耗及集成密度等关键指标上的整体性能。在 2028 年至 2029 年期间，计划致力于 3.2T 光模块的量产准备及产量提升，同时投入下一代光模块的研发。与此同时，预计将开发针对下一代 AI 网络及高带宽应用的 XPO、NPO 和 CPO 产品，在未来高性能光互联解决方案中建立先发优势。

中际旭创表示，短期内的产品研发方向专注于推出 3.2T 光模块、开发不同传输距离的产品，以及拓宽使用场景。同时致力于巩固在相干、LPO 及 LRO 等成熟技术领域的领先地位，并投资于核心器件的研发。也会继续投资 NPO 及 CPO 等新兴规模化扩展解决方案，同时进一步渗透与现有光互连产品具有协同效应或互补性的新细分市场，例如 OCS。通过打造光模块以外的新增长引擎，力求拓展业务边界并进一步扩大市场份额。

中际旭创表示，其 XPO、NPO 及 CPO 解决方案目前处于研发及样品交付阶段，而 LPO 及 LRO 解决方案已进入量产阶段。截至最后实际可行日期，通过 LPO 及 LRO 解决方案获得收入 11 亿元人民币，通过 XPO、NPO 及 CPO 解决方案获得收入 200 万元人民币。

台积电 Q2 财报利润大幅增长超预期（微信公众号：格隆汇 APP）

下载日志已记录，仅供内部参考

台积电交出了超亮眼的 2026 年 Q2 财报成绩单。台积电二季度营收达 12703.81 亿新台币（折合 402 亿美元），同比大涨 36%。利润端的爆发力更为突出，季度净利润 7065.62 亿新台币，约 219.9 亿美元，同比飙升 77.4%，大幅甩开各大机构此前给出的预测值。美股 ADR 口径下，台积电单季每股收益达 4.31 美元，较去年同期的 2.47 美元增长 74.49%，较分析师预期高出 14.32%；销售额也小幅超预期。

数据显示，公司 Q2 毛利率站稳 67.7%，同比提升 9.1 个百分点，环比持续攀升，突破自身此前给出的业绩指引上限。

从制程营收结构能清晰看出台积电的赚钱逻辑：

本季度台积电 2 纳米制程正式商业化落地，开始贡献营收，占晶圆总营收的 3%，目前正处于稳步爬坡阶段；3 纳米、5 纳米作为当下的主力制程，分别拿下 30%、33%的营收占比；7 纳米制程占比 11%。整体统计来看，7 纳米及更先进制程合计包揽 77%的晶圆营收，高端制程占比持续提升。

这些高毛利产能，主要承接英伟达 AI 芯片、苹果旗舰处理器等头部客户订单，是业绩高增的核心底气。AI 算力业务成为绝对增长主力，二季度高性能计算业务营收环比大涨 20%，受益于全球 AI 大模型迭代、算力基建大规模建设，AI 芯片订单持续爆满，稳稳撑起公司业绩大盘。

反观传统消费电子赛道则表现平淡，智能手机业务营收环比下滑 4%，仅呈现季节性波动，增长乏力，完全无法对冲 AI 赛道的强势红利，行业结构性分化愈发明显。彭博分析师 Charles Shum 在业绩发布后表示，台积电 6 月销售数据进一步强化了 AI 及服务器处理器需求将抵消智能手机与 PC 市场疲软的判断，并认为这为台积电推进提价奠定基础，有望将毛利率展望推升至 67.5%的指引上限附近，高于市场当前共识预期的 67.1%。

公司二季度单季资本支出高达 157 亿美元，环比明显提升。台积电预计 2026 年资本支出为 600 亿-640 亿美元(此前预测为 520 亿-560 亿美元区间的高端)。资金重点投向中国台湾本土 2 纳米、3 纳米先进产能扩建，以及 CoWoS 先进封装产线扩容，同时稳步推进美国、日本海外建厂计划等。

对于三季度业绩指引，台积电预计：今年第三季度营收为 446 亿-458 亿美元(2025 年第三季度为 331 亿美元)，市场预期 431.1 亿美元；预计第三季度毛利率为 65%－67%(第二季度为 67.7%)，市场预期 65.9%；预计第三季度营业利润率为 56%－58%(第二季度为 60.3%)。

华工正源联合发起 OPEN NPO，加速 AI 超节点规模化商用（微信公众号：光纤在线）

近日，由 GCC-Open AI Infra 社区主办的“超节点与 GW 级 AIDC 技术论坛暨 Open AI Infra 社区半年工作会议”在北京举行。会上，国内首个 NPO 光互连 MSA（多源协议）——OPEN NPO 项目正式启动。华工正源作为核心受邀单位，携手 20 余家半导体、光通信、算力领域上下游头部企业，共同发起共建 OPEN NPO 产业项目，标志着我国近封装光学（NPO）领域正式告别“各自为战”的碎片化发展模式，迈入标准统一、生态共建、规模化商用的全新产业阶段。

本次会议启动了国内首个 NPO 光互联 MSA（多源协议），标志着我国近封装光学领域从“各自为战”走向“书同文、车同轨”的产业协同新阶段。项目聚焦超节点近封装光电互联核心领域，重点覆盖 NPO 机械规格、电气规格、环境可靠性及管控运维等方面的标准制定，针对电连接器接口，核心团队成员共同制定并输出包含 2D-3D 图纸在内的精细化规格定义文件。保障多厂商产品互配兼容。

2.2. 商业航天行业动态

长征十号乙完成全球首次海上网系回收（微信公众号：央视新闻）

7 月 10 日 12 时 15 分，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空，将卫星顺

下载日志已记录，仅供内部参考

利送入预定轨道，火箭一二级分离约 6 分钟后，一子级垂直返回，在海上回收平台通过网系捕获方式成功回收，发射及一子级回收任务取得圆满成功。此次任务是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，同时也是全球首次运载火箭网系回收，标志着我国在重复使用火箭技术领域取得历史性突破，将为加快提升我国进出空间能力奠定坚实基础。长征十号乙运载火箭成为我国首型成功实施回收的重复使用运载火箭。

长征十号乙运载火箭由中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院抓总研制，为 5 米直径两级串联构型大型液体运载火箭，芯一级沿用长征十号甲运载火箭一子级状态，采用液氧煤油推进剂，芯二级采用液氧甲烷推进剂，全箭起飞推力约 890 吨，起飞重量约 760 吨，首飞箭全箭长度约 63 米，重复使用状态下近地轨道运载能力 16 吨，可满足低轨卫星互联网星座部署、大型商业卫星发射等各类任务需求，复用状态下可大幅降低发射成本，具有大运力、高性价比的优势。此次任务是继长征十号系列运载火箭低空演示验证飞行并在海上安全溅落后对重复使用火箭回收技术的进一步验证。

本次首飞任务成功验证了组合构型总体优化设计技术、大推力箱底传力技术、甲烷自生增压技术等核心关键技术，特别是成功验证了基于隔板贮箱的推进剂管理技术、发动机多次启动和高空点火、复杂力热环境适应性、高精度导航控制、海上平台网系捕获回收等多项一子级重复使用关键核心技术。后续，长征十号乙运载火箭研制团队将持续优化火箭性能，加快重复使用火箭技术的迭代升级，预计将在今年年底前完成一子级火箭复用飞行。

3. 本周行业投资观点

本周投资观点：

冲突局势动荡，影响市场风偏和流动性，对 AI 科技产业也产生了预期的扰动。我们仍坚定看好算力产业链核心标的的投资机会，AI 带动算力供应链核心标的有望实现较好的业务增长，重视产业链核心厂商。其中，海外算力产业链高景气度依旧，相关公司财报持续体现 AI 相关需求的高景气，相关产业链的基本面共振更强，我们持续看好海外算力产业链投资机会。国内方面，后续伴随着国产算力持续发展，大厂如阿里、字节等对于 AI 的持续投资，仍然看好 AI 行业以及围绕 AIDC 产业链的持续高景气。整体上我们积极看好 26 年国内 AI 基础设施需求延续高景气，同时应用有望持续开花结果。中美 AI 均进展不断，同时推理端持续推进。建议持续关注 AI 产业动态及 AI 应用的投资机会。

我们建议持续重视“AI+出海+卫星”核心标的的投资机会：海外线 AI 核心方向如光模块&光器件、液冷等领域值得重视，持续核心推荐；此外国产算力线如国产服务器，交换机，AIDC、液冷等方向核心标的建议积极关注。海风行业国内加速复苏，海外出海具备良好机遇，积极把握产业变化，核心推荐海缆龙头厂商。近期看到商业航天产业国内动态进展呈现，看好后续产业受催化拉动。

中长期我们持续推荐 AI 算力方向核心受益的优质标的以及高景气格局好的细分赛道方向：1）AI 和数字经济仍为强主线，未来需要紧抓核心受益标的：ICT 设备、光模块/光芯片、PCB、IDC/液冷散热、GPT 应用、电信运营商（数字经济+工业互联网）等相关公司都有望迎来新机遇。2）商业航天&“天地一体化”为 6G 重点方向，建议关注通导遥各细分赛道。3）海风未来几年持续高景气，海缆壁垒高&格局好&估值低，投资机会凸显。

人工智能&数字经济是未来产业长期大趋势：算力+网络+存储+散热为主要受益方向，AI 新科技浪潮将持续拉动 ICT 设备商、光通信、PCB、散热温控等需求，长期重视其相关投资机会；

以满足流量增长为目标的有线网络扩容：随着 5G 用户渗透，网络流量快速提升，光传输、光模块等扩容升级迫在眉睫；

以满足应用和内容增长需求的云计算基础设施和物联网硬件终端投资：ISP 厂商基于新应用和新内容增长，加大云计算基础设施投入，包括 IDC、网络路由交换、服务器、配套温

下载日志已记录，仅供内部参考

控电源、光模块及光器件的新一轮景气提升。

双碳长期目标下，重点关注通信+新能源，另外应用端，云视频、数据、物联网/智能汽车、工业互联网、商业航天等行业应用进入加速发展阶段，中长期成长逻辑清晰，进入重点关注阶段。

具体细分行业来看：

一、人工智能与数字经济：

1、光模块&光器件，**推荐：中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技（电子联合覆盖）；相关标的：东山精密、剑桥科技、长芯博创、仕佳光子、鼎通科技**、光库科技、**华懋科技（电新汽车团队联合覆盖）**、致尚科技、罗博特科、中瓷电子、太辰光、德科立等。

2、光纤光缆，**推荐：亨通光电、中天科技、长飞光纤、永鼎股份**；相关标的：杭电股份、特发信息、通鼎互联等。

3、交换机服务器 PCB：推荐：**沪电股份（电子组联合覆盖）、菲菱科思；相关标的：盛科通信、锐捷网络、胜宏科技**、三旺通信、映翰通等。

4、低估值、高分红，云和算力 idc 资源重估：**中国移动、中国电信、中国联通**。

5、AIDC&散热：推荐：**英维克（机械联合覆盖）、润泽科技（机械联合覆盖）、润建股份、光环新网、科华数据（电新联合覆盖）、奥飞数据（计算机联合覆盖）**、数据港（计算机联合覆盖）。相关标的：**大位科技**、申菱环境（家电覆盖）、宏景科技、高澜股份、科创新源等。

6、AIGC 应用/端侧算力，推荐：**移远通信、广和通、美格智能**，相关标的：**彩讯股份、梦网科技**、翱捷科技（电子团队覆盖）。

二、物联网&智能驾驶：

1、出海复苏&头部集中，推荐：**威胜信息（机械联合覆盖）、拓邦股份（电子联合覆盖）、亿联网络**、广和通、美格智能等，相关标的：**华测导航、和而泰（电子家电团队联合覆盖）、移远通信**、移为通信。

2、智能驾驶：相关标的：模组&终端（广和通、美格智能、移远通信、移为通信等）；传感器（汉威科技&四方光电-机械联合覆盖）；连接器（意华股份、鼎通科技等）；结构件&空气悬挂（瑞玛精密）等。

三、商业航天：

低轨卫星加速发展，低空经济积极推进，相关标的：**铖昌科技**、盛路通信、**信科移动、华测导航**、佳缘科技、盟升电子、中国卫通、震有科技、通宇通讯等。

其他细分领域标的：**中兴通讯、紫光股份（计算机联合覆盖）、亨通光电、中天科技、光迅科技、烽火通信、海格通信、上海瀚讯**、海能达、电科网安。

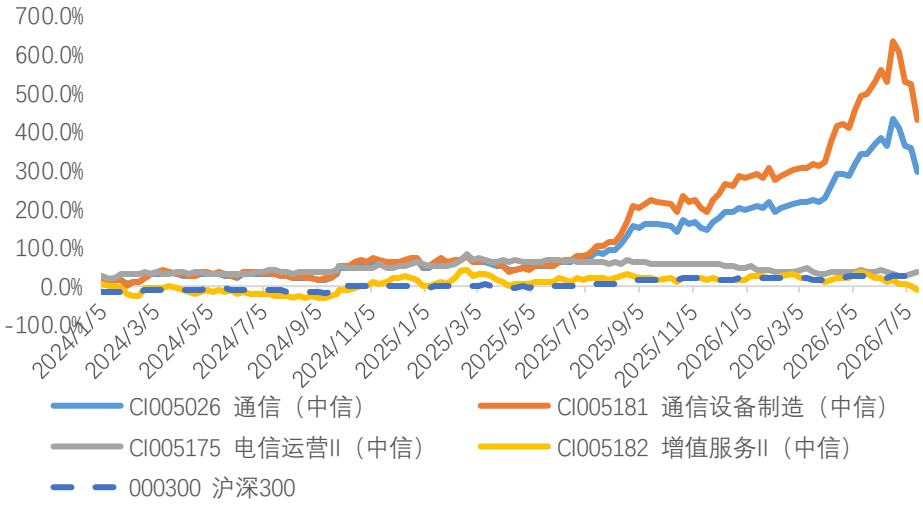
4. 板块表现回顾

4.1. 本周（07.13-07.17）通信板块走势

本周（07.13-07.17）通信板块下跌 13.59%，跑输沪深 300 指数 8.32 个百分点，跑输创业板指数 2.81 个百分点。其中通信设备制造下跌 14.81%，增值服务下跌 11.12%，电信运营上涨 4.23%，同期沪深 300 下跌 5.26%，创业板指数下跌 10.78%。

图 5：本周（07.13-07.17）板块涨跌幅

下载日志已记录，仅供内部参考



资料来源：Wind，天风证券研究所

4.2. 本周市场个股表现

本周通信板块涨幅靠前的个股有*ST 天喻、广和通、天音控股；跌幅靠前的个股有信科移动、国博电子、ST 臻镭。

表 1：本周（07.13-07.17）通信板块个股涨跌幅前十

涨幅前十			跌幅前十		
证券代码	证券简称	周涨幅（%）	证券代码	证券简称	周涨幅（%）
300205	*ST 天喻	10.00%	688385	复旦微电	-29.78%
300638	广和通	9.94%	600498	烽火通信	-30.37%
000829	天音控股	9.33%	300560	中富通	-31.16%
002396	星网锐捷	9.03%	688182	灿勤科技	-31.87%
002881	美格智能	7.88%	688418	震有科技	-33.00%
300628	亿联网络	6.62%	300762	上海瀚讯	-33.41%
601728	中国电信	6.56%	300689	澄天伟业	-33.95%
300050	世纪鼎利	6.32%	688270	ST 臻镭	-34.97%
603118	共进股份	5.28%	688375	国博电子	-39.39%
002115	三维通信	5.11%	688387	信科移动-U	-40.89%

资料来源：Wind，天风证券研究所

5. 下周（07.20-07.24）上市公司重点公告提醒

表 2：下周（07.20-07.24）通信板块上市公司重点公告提醒

星期	日期	公司	事件
周一	7 月 20 日	震有科技	股东大会召开
		中贝通信	分红除权
		中贝通信	分红派息
周二	7 月 21 日	*ST 元道	股东大会召开
		美格智能、润建股份	分红派息
		美格智能、润建股份	分红除权
		长芯博创	限售股份上市流通
周四	7 月 23 日	润建股份、宏景科技	股东大会召开
		生益科技	限售股份上市流通
周五	7 月 24 日	爱施德、光庭信息、生益科技、瑞可达	股东大会召开

资料来源：Wind，天风证券研究所

下载日志已记录，仅供内部参考

6. 重要股东增减持

表 3：本周公告通信股重要股东增减持

名称	变动截止日期	股东类型	方向	变动数量(万股)	占总股本比例(%)	交易平均价（元）	7 月 17 日收盘价（元）	周内股价变动
爱施德	2026-07-14	高管	增持	11.4700	0.009%	8.93	9.10	2.71%
爱施德	2026-07-14	高管	增持	3.0100	0.002%	8.76	9.10	2.71%
爱施德	2026-07-14	高管	增持	3.0600	0.002%	8.99	9.10	2.71%
三维通信	2026-07-13	高管	减持	200.0000	0.248%	11.58	11.51	5.11%
华测导航	2026-07-10	高管	增持	4.0000	0.005%	26.87	26.54	-8.17%
华测导航	2026-07-14	高管	增持	9.5000	0.012%	27.39	26.54	-8.17%
恒实科技	2026-07-10	公司	增持	159.0000	0.507%		6.84	-2.98%
瑞可达	2026-07-10	高管	减持	0.8736	0.003%	85.00	61.41	-22.42%
*ST 亿通	2026-07-14	个人	减持	263.9000	0.868%		6.82	-10.85%
瑞玛精密	2026-06-23	公司	减持	48.1000	0.247%		21.50	-19.32%

资料来源：Wind，天风证券研究所

7. 限售解禁

未来三个月限售解禁通信股共 9 家，解禁股份数量占总股本比例超过 15%的公司有中贝通信、中瓷电子、信科移动-U。

表 4：未来三个月通信股限售解禁

公司名称	解禁日期	解禁数量(万股)	占总股本比	7 月 17 日收盘价（元）	解禁股市价（万元）	解禁股份类型
长芯博创	2026-07-21	2,200.00	7.46%	166.21	365,662.00	定向增发机构配售股份
生益科技	2026-07-23	1,724.73	0.71%	132.29	228,164.70	股权激励限售股份
深桑达 A	2026-07-30	7,722.01	6.35%	15.48	119,536.68	定向增发机构配售股份
中贝通信	2026-08-05	10,208.58	19.03%	17.18	175,383.49	定向增发机构配售股份
中瓷电子	2026-09-11	11,089.62	24.59%	107.28	1,189,694.04	定向增发机构配售股份
盛科通信-U	2026-09-14	604.69	1.47%	312.00	188,662.75	首发战略配售股份
信科移动-U	2026-09-28	140,197.28	41.01%	13.17	1,846,398.18	首发原股东限售股份
广哈通信	2026-09-30	3,126.30	11.15%	14.36	44,893.71	定向增发机构配售股份
长盈通	2026-10-13	640.64	4.97%	101.73	65,172.06	定向增发机构配售股份

资料来源：Wind，天风证券研究所

下载日志已记录，仅供内部参考

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。
本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。
本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。
天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益-10%-10%
		卖出	预期股价相对收益-10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅-5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅-5%以下

天风证券研究

北京	海口	上海	深圳
北京市西城区德胜国际中心 B 座 11 层	海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 A 栋 23 层 2301 房	上海市虹口区东长治路 855 号北外滩金茂中心 T1 栋 19 楼	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼
邮编：100088	邮编：570102	邮编：200082	邮编：518000
邮箱：research@tfzq.com	电话：(0898)-65365390	电话：(8621)-60256006	电话：(86755)-23915663
	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com	传真：(86755)-82571995
			邮箱：research@tfzq.com